

2023-2029年中国汽车芯片 市场评估与未来发展趋势报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国汽车芯片市场评估与未来发展趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202301/334845.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国汽车芯片市场评估与未来发展趋势报告》共十一章。首先介绍了汽车芯片行业市场发展环境、汽车芯片整体运行态势等，接着分析了汽车芯片行业市场运行的现状，然后介绍了汽车芯片市场竞争格局。随后，报告对汽车芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了汽车芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对汽车芯片产业有个系统的了解或者想投资汽车芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 2017-2022年汽车半导体行业发展综合分析

1.1 汽车半导体基本概述

1.1.1 汽车半导体发展历程

1.1.2 汽车半导体基本要求

1.1.3 汽车半导体主要类型

1.1.4 汽车半导体产业链条

1.1.5 汽车半导体价值构成

1.2 全球汽车半导体行业发展现状

1.2.1 汽车半导体市场规模

1.2.2 汽车领域半导体收入

1.2.3 汽车半导体产品结构

1.2.4 汽车半导体区域分布

1.2.5 汽车半导体竞争格局

1.2.6 汽车半导体应用占比

1.2.7 美国汽车半导体发展

1.2.8 欧洲汽车半导体市场

1.2.9 日韩汽车半导体实力

1.3 中国汽车半导体行业发展态势

1.3.1 汽车半导体市场规模

- 1.3.2 汽车半导体主要企业
- 1.3.3 中国汽车半导体实力
- 1.3.4 汽车半导体需求前景
- 1.3.5 汽车半导体市场空间
- 1.3.6 汽车半导体发展问题
- 1.3.7 汽车半导体发展建议
- 1.4 中国汽车功率半导体行业发展状况
 - 1.4.1 功率半导体主要类型
 - 1.4.2 IGBT生产工艺流程分析
 - 1.4.3 IGBT市场竞争格局分析
 - 1.4.4 国内主要汽车IGBT厂商
 - 1.4.5 MOSFET市场竞争格局
 - 1.4.6 功率半导体发展机遇

第二章 2017-2022年全球汽车芯片行业发展状况

- 2.1 2017-2022年全球汽车芯片市场运行分析
 - 2.1.1 汽车芯片发展现状
 - 2.1.2 汽车芯片市场规模
 - 2.1.3 汽车芯片区域分布
 - 2.1.4 汽车芯片市场结构
 - 2.1.5 汽车芯片竞争格局
 - 2.1.6 汽车芯片竞争态势
 - 2.1.7 汽车芯片价格变动
 - 2.1.8 汽车芯片供需分析
- 2.2 全球汽车芯片细分领域发展现状
 - 2.2.1 功能芯片领域
 - 2.2.2 主控芯片领域
 - 2.2.3 存储芯片领域
 - 2.2.4 通信芯片领域
 - 2.2.5 功率芯片领域
- 2.3 全球各地区汽车芯片市场发展动态
 - 2.3.1 美国

- 2.3.2 欧洲
- 2.3.3 亚洲
- 2.3.4 日本
- 2.4 全球汽车芯片短缺状况及影响分析
 - 2.4.1 全球汽车芯片短缺现状
 - 2.4.2 芯片短缺对车企的影响
 - 2.4.3 芯片短缺对汽车业的冲击
 - 2.4.4 汽车芯片短缺的原因分析
 - 2.4.5 汽车芯片短缺应对措施

第三章 2017-2022年中国汽车芯片行业发展环境分析

- 3.1 经济环境
 - 3.1.1 国民经济运行
 - 3.1.2 工业经济运行
 - 3.1.3 固定资产投资
 - 3.1.4 转型升级形势
 - 3.1.5 宏观经济展望
 - 3.1.6 宏观趋势分析
- 3.2 政策环境
 - 3.2.1 汽车半导体政策
 - 3.2.2 产业创新战略联盟
 - 3.2.3 汽车芯片扶持政策
 - 3.2.4 人大代表相关建议
 - 3.2.5 新能源车发展规划
 - 3.2.6 智能网联汽车政策
- 3.3 汽车工业运行
 - 3.3.1 行业发展形势
 - 3.3.2 汽车产销规模
 - 3.3.3 新能源汽车市场
 - 3.3.4 外贸市场状况
 - 3.3.5 汽车企业业绩
 - 3.3.6 行业发展趋势

3.3.7 发展前景展望

3.4 社会环境

3.4.1 智能网联汽车发展

3.4.2 新能源汽车智能化

3.4.3 疫情及突发事件影响

第四章 2017-2022年中国汽车芯片行业发展分析

4.1 中国汽车芯片行业重要性分析

4.1.1 汽车芯片主要类型

4.1.2 汽车芯片行业地位

4.1.3 汽车芯片自主可控

4.1.4 汽车芯片发展形势

4.1.5 汽车芯片发展必要性

4.2 2017-2022年中国汽车芯片市场现状

4.2.1 汽车芯片使用数量

4.2.2 汽车芯片市场规模

4.2.3 国产汽车芯片现状

4.2.4 汽车芯片供给现状

4.2.5 汽车芯片需求现状

4.2.6 汽车芯片供需失衡

4.3 中国汽车芯片市场短缺现状分析

4.3.1 汽车芯片短缺现状

4.3.2 芯片短缺表面原因

4.3.3 芯片短缺本质原因

4.3.4 芯片短缺短期影响

4.3.5 芯片荒中长期影响

4.3.6 汽车芯片短缺的思考

4.4 2017-2022年中国汽车芯片市场竞争形势

4.4.1 汽车芯片相关企业数量

4.4.2 汽车芯片产业区域分布

4.4.3 汽车芯片市场竞争现状

4.4.4 汽车芯片厂商布局现状

- 4.4.5 汽车厂商芯片领域布局
- 4.4.6 汽车芯片赛道竞争态势
- 4.4.7 汽车芯片国产替代加速
- 4.4.8 汽车芯片未来竞争格局
- 4.5 中国汽车微控制器（MCU）市场现状分析
 - 4.5.1 MCU在汽车上的应用
 - 4.5.2 MCU芯片市场规模分析
 - 4.5.3 国内MCU产品结构分析
 - 4.5.4 国内MCU市场竞争格局
 - 4.5.5 MCU市场应用领域占比
 - 4.5.6 汽车MCU短缺现状分析
 - 4.5.7 汽车MCU短缺核心原因
 - 4.5.8 MCU短缺预计持续时间
- 4.6 中国汽车芯片技术发展状况
 - 4.6.1 汽车芯片工艺要求
 - 4.6.2 汽车芯片技术标准
 - 4.6.3 汽车芯片研发周期
 - 4.6.4 汽车芯片制造工艺
 - 4.6.5 车规级芯片技术现状
- 4.7 中国汽车芯片行业发展困境分析
 - 4.7.1 汽车芯片共性问题
 - 4.7.2 汽车芯片技术问题
 - 4.7.3 汽车芯片发展痛点
 - 4.7.4 车规级芯片亟待突破
 - 4.7.5 汽车芯片自给率不足
- 4.8 中国汽车芯片市场对策建议分析
 - 4.8.1 构建汽车芯片产业生态
 - 4.8.2 汽车芯片产业发展建议
 - 4.8.3 精准扶持汽车芯片产业
 - 4.8.4 汽车芯片行业政策建议
 - 4.8.5 汽车芯片产业发展路径

第五章 中国汽车芯片产业链发展解析

5.1 汽车芯片产业链发展综述

5.1.1 汽车芯片产业链结构分析

5.1.2 汽车芯片产业链自给能力

5.1.3 汽车芯片产业链厂商格局

5.1.4 汽车芯片企业产业链布局

5.1.5 芯片短缺对产业链的影响

5.1.6 汽车芯片产业链价格波动

5.1.7 汽车芯片产业链发展建议

5.2 汽车芯片行业供应链发展分析

5.2.1 芯片供应区域格局

5.2.2 汽车工业供应链变革

5.2.3 芯片企业供应链节奏

5.2.4 汽车芯片供应链问题

5.2.5 汽车企业供应链管理

5.3 汽车芯片上游材料及设备市场分析

5.3.1 半导体材料的主要类型

5.3.2 材料紧缺对行业的影响

5.3.3 芯片短缺对光刻胶的影响

5.3.4 车用8英寸晶圆产能不足

5.3.5 晶圆代工厂产能扩大状况

5.3.6 消费电子芯片挤占产能

5.3.7 半导体设备行业发展机遇

5.4 汽车芯片中游制造产业分析

5.4.1 汽车芯片产能现状分析

5.4.2 汽车芯片制造模式分析

5.4.3 汽车芯片制造商议价能力

5.4.4 芯片代工封测端景气度

5.5 汽车芯片下游应用市场需求分析

5.5.1 行业应用领域

5.5.2 整车制造市场

5.5.3 新能源车市场

5.5.4 自动驾驶市场

第六章 2017-2022年汽车芯片主要应用市场发展分析

6.1 ADAS领域

6.1.1 ADAS行业发展现状

6.1.2 新车ADAS装配率

6.1.3 ADAS市场发展态势

6.1.4 主控芯片应用需求

6.1.5 汽车AI芯片发展机遇

6.1.6 汽车智能化加速缺芯

6.1.7 汽车智能芯片需求前景

6.2 汽车传感器领域

6.2.1 汽车传感器主要类型

6.2.2 各类车载雷达市场规模

6.2.3 车载摄像头市场规模

6.2.4 汽车传感器芯片需求

6.2.5 CMOS图像传感器芯片

6.2.6 汽车导航定位芯片分析

6.2.7 汽车车载雷达芯片分析

6.3 智能座舱领域

6.3.1 智能座舱产业链结构

6.3.2 智能座舱市场规模分析

6.3.3 车企智能座舱产品配置

6.3.4 智能座舱芯片发展现状

6.3.5 智能座舱芯片参与主体

6.3.6 智能座舱芯片竞争格局

6.3.7 智能座舱市场发展机遇

6.4 车联网领域

6.4.1 车联网行业利好政策

6.4.2 车联网市场规模分析

6.4.3 车联网产业区域布局

6.4.4 车联网市场竞争格局

6.4.5 车联网下芯片需求趋势

6.5 自动驾驶领域

6.5.1 自动驾驶等级及产业链

6.5.2 自动驾驶芯片发展现状

6.5.3 自动驾驶芯片供应链

6.5.4 自动驾驶芯片竞争格局

6.5.5 自动驾驶处理器芯片

6.5.6 自动驾驶芯片规模预测

6.5.7 国产自动驾驶芯片机遇

6.5.8 芯片未来竞争格局预判

第七章 2017-2022年中国汽车电子市场发展分析

7.1 中国汽车电子行业发展概述

7.1.1 汽车电子产业链

7.1.2 汽车电子驱动因素

7.1.3 汽车电子发展特点

7.1.4 汽车智能计算平台

7.1.5 智能座舱率先落地

7.2 2017-2022年中国汽车电子市场发展分析

7.2.1 汽车电子成本

7.2.2 市场规模现状

7.2.3 市场结构分析

7.2.4 汽车电子渗透率

7.3 汽车电子市场竞争分析

7.3.1 全球汽车电子格局

7.3.2 汽车电子竞争格局

7.3.3 细分产业格局分析

7.3.4 车身电子竞争现状

7.3.5 车载电子系统竞争

7.3.6 区域竞争格局分析

7.4 汽车电子市场发展存在的问题

7.4.1 汽车电子标准化问题

- 7.4.2 汽车电子技术发展问题
- 7.4.3 汽车电子行业应用问题
- 7.5 中国汽车电子市场发展策略及建议
 - 7.5.1 汽车电子行业政策建议
 - 7.5.2 汽车电子产业发展建议
 - 7.5.3 汽车电子企业发展建议
 - 7.5.4 汽车电子供应链建设策略
- 7.6 中国汽车电子市场前景展望
 - 7.6.1 汽车电子外部形势
 - 7.6.2 汽车电子发展前景
 - 7.6.3 汽车电子发展机遇
 - 7.6.4 汽车电子发展趋势
 - 7.6.5 关键技术应用趋势
 - 7.6.6 汽车电子发展方向

第八章 国外汽车芯片重点企业经营分析

- 8.1 博世集团（Bosch）
- 8.2 美国微芯科技公司
- 8.3 瑞萨电子株式会社
- 8.4 恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）
- 8.5 英飞凌科技公司（Infineon Technologies AG）
- 8.6 意法半导体（STMicroelectronics N.V.）
- 8.7 德州仪器（Texas Instruments）
- 8.8 安森美半导体（On Semiconductor）

第九章 中国汽车芯片重点企业运营分析

- 9.1 比亚迪半导体股份有限公司
 - 9.1.1 企业发展概况
 - 9.1.2 企业经营状况
 - 9.1.3 汽车芯片业务
 - 9.1.4 企业竞争优势
 - 9.1.5 企业融资动态

9.1.6 企业发展前景

9.2 北京地平线机器人技术研发有限公司

9.2.1 企业发展概况

9.2.2 汽车芯片业务

9.2.3 车企战略合作

9.2.4 企业合作动态

9.2.5 企业融资动态

9.2.6 企业技术优势

9.3 北京四维图新科技股份有限公司

9.3.1 企业发展概况

9.3.2 经营效益分析

9.3.3 业务经营分析

9.3.4 财务状况分析

9.3.5 核心竞争力分析

9.3.6 公司发展战略

9.4 闻泰科技股份有限公司

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 汽车芯片业务

9.4.3 企业投资动态

9.4.4 经营效益分析

9.4.5 业务经营分析

9.4.6 财务状况分析

9.5 上海韦尔半导体股份有限公司

9.5.1 企业发展概况

9.5.2 经营效益分析

9.5.3 业务经营分析

9.5.4 财务状况分析

9.5.5 核心竞争力分析

9.5.6 公司发展战略

9.6 中芯国际集成电路制造有限公司

9.6.1 企业发展概况

9.6.2 经营效益分析

- 9.6.3 业务经营分析
- 9.6.4 财务状况分析
- 9.6.5 核心竞争力分析
- 9.6.6 公司发展战略
- 9.7 嘉兴斯达半导体股份有限公司
 - 9.7.1 企业发展概况
 - 9.7.2 经营效益分析
 - 9.7.3 业务经营分析
 - 9.7.4 财务状况分析
 - 9.7.5 核心竞争力分析
 - 9.7.6 公司发展战略
- 9.8 珠海全志科技股份有限公司
 - 9.8.1 企业发展概况
 - 9.8.2 经营效益分析
 - 9.8.3 业务经营分析
 - 9.8.4 财务状况分析
 - 9.8.5 核心竞争力分析
 - 9.8.6 公司发展战略

第十章 中国汽车芯片行业投资潜力分析

- 10.1 中国汽车芯片行业投融资现状分析
 - 10.1.1 汽车芯片融资现状
 - 10.1.2 资本加大投资力度
 - 10.1.3 汽车芯片技术投资
 - 10.1.4 汽车芯片并购态势
- 10.2 中国汽车芯片投资机遇分析
 - 10.2.1 产业链投资机遇
 - 10.2.2 汽车芯片介入时机
 - 10.2.3 汽车芯片投资方向
 - 10.2.4 汽车芯片投资前景
 - 10.2.5 汽车芯片投资建议
- 10.3 中国汽车芯片产业投融资动态

- 10.3.1 北汽产投
- 10.3.2 芯驰科技
- 10.3.3 裕太微电子
- 10.3.4 芯旺微电子
- 10.3.5 东风汽车
- 10.3.6 黑芝麻智能科技
- 10.4 中国汽车芯片细分领域投资机会
 - 10.4.1 MCU投资机会
 - 10.4.2 SoC投资机会
 - 10.4.3 存储芯片机会
 - 10.4.4 功率半导体机会
 - 10.4.5 传感器芯片机会
- 10.5 汽车芯片行业投资壁垒分析
 - 10.5.1 汽车半导体进入壁垒
 - 10.5.2 汽车半导体主要标准
 - 10.5.3 汽车半导体资金壁垒
 - 10.5.4 汽车电子芯片投资壁垒
 - 10.5.5 汽车芯片行业进入壁垒

第十一章 2023-2029年中国汽车芯片产业未来发展前景展望

- 11.1 全球汽车芯片产业发展前景及趋势预测
 - 11.1.1 全球汽车芯片需求前景
 - 11.1.2 全球汽车芯片规模预测
 - 11.1.3 汽车芯片供需状况预测
 - 11.1.4 全球汽车芯片发展趋势
- 11.2 中国汽车芯片产业发展前景及趋势分析
 - 11.2.1 汽车芯片短缺影响因素
 - 11.2.2 汽车芯片短缺时间预测
 - 11.2.3 汽车芯片短缺影响预测
 - 11.2.4 国产汽车芯片发展前景
 - 11.2.5 MCU及存储器发展前景
 - 11.2.6 汽车芯片行业发展机遇

- 11.2.7 汽车芯片行业发展趋势
- 11.3 2023-2029年中国汽车芯片行业预测分析
 - 11.3.1 2023-2029年中国汽车芯片行业影响因素分析
 - 11.3.2 2023-2029年中国MCU市场规模预测
 - 11.3.3 2023-2029年中国汽车半导体市场规模预测

图表目录

- 图表1 汽车半导体发展历程
 - 图表2 汽车半导体类别
 - 图表3 汽车半导体一级、二级分类
 - 图表4 汽车半导体产业链
 - 图表5 汽车半导体代表公司
 - 图表6 汽车半导体构成
 - 图表7 不同自动化程度的单车半导体平均价值
 - 图表8 不同电气化程度的单车半导体平均价值
 - 图表9 燃油车半导体价值构成
 - 图表10 纯电动车半导体价值构成
- 更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202301/334845.html>